

第36回春季講演大会 プログラム (3月23日)

論文NO	発表日	start	発表カテゴリ	発表分類	タイトル	著者	所属
23A1-1	3月23日	9:00	(03) サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装	論文発表	メッキプロセスによるパワーデバイス用銅柱グラファイト放熱板	○北村駿 [†] ・山田靖 [†] ・竹馬克洋 ^{††} ・俊成修平 ^{††}	大同大学 [†] (株) サーマグラフィティクス ^{††}
23A1-2	3月23日	9:15	(03) サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装	論文発表	水冷式ピンフィン型ヒートシンクの冷却性能評価のための熱回路モデル構築に関する基礎検討	○齋藤晃太、畠山友行、木伏理沙子、石塚勝	富山県立大学
23A1-3	3月23日	9:30	(03) サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装	論文発表	熱負荷の可視化技術を用いたパワーサイクル試験時のひずみの解析精度向上	○佐藤克哉、矢尾板明子、山本哲也	(株) 東芝
23A1-4	3月23日	9:45	(03) サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装	論文発表	定常法熱抵抗計測における熱損失が測定精度に与える影響	○中村裕介	富山県立大学
23A2-1	3月23日	10:20	(03) サーマルマネジメント&信頼性解析技術	論文発表	大面積接合劣化検出技術	○谷澤秀和 [†] 、宝蔵寺裕之 ^{††} 、加藤史樹 ^{††} 、佐藤嘉洋 [†] 、佐藤弘 ^{††}	[†] サンケン電気㈱、 ^{††} 産業技術総合研究所
23A2-2	3月23日	10:35	(03) サーマルマネジメント&信頼性解析技術	論文発表	225℃動作SiCモジュールのパワーサイクル長寿命化	○田中聡 ^{††} 、新開次郎 ^{††} 、宝蔵寺裕之 [†] 、加藤史樹 [†] 、池川正人 [†] 、佐藤弘 [†] 、倉島宏美 ^{††}	[†] 産業技術総合研究所、 ^{††} 住友電気工業(株)
23A2-3	3月23日	10:50	(03) サーマルマネジメント&信頼性解析技術	論文発表	放射光X線を用いたはんだの非破壊方位マッピング	○林雄二郎、KimJaemyung、矢橋牧名	理化学研究所
23A2-4	3月23日	11:05	(03) サーマルマネジメント&信頼性解析技術	論文発表	Cu-Sn系IMC接合材を用いたパワーモジュールの信頼性評価	○首藤高德 [†] 、園田正樹 [†] 、上野竜太 [†] 、本田さほ [†] 、橋口智和 [†] 、杉木昭雄 ^{††} 、橋本博典 ^{††} 、梅木誠 ^{††}	[†] 大分県産業科学技術センター、 ^{††} 大分デバイステクノロジー(株)
23B1-1	3月23日	9:00	(04) 部品内蔵技術	依頼講演	部品内蔵基板を用いた三次元実装技術と国際標準化活動	○加藤義尚	福岡大学半導体実装研究所
23B1-2	3月23日	9:30	(04) 部品内蔵技術	依頼講演	3Dプリンタを活用した部品内蔵基板の設計製造フロー	○松澤浩彦	(株) 因研
23B2-1	3月23日	10:20	(18) システムインテグレーション実装技術	依頼講演	国家プロジェクトにおける3次元集積実装技術の研究開発とシステムインテグレーション技術への展開	○菊地克弥	産業技術総合研究所
23B2-2	3月23日	10:50	(18) システムインテグレーション実装技術	論文発表	ESD対応バックグラウンドテープの開発	○安達一政、田村和幸	リンテック㈱
23B2-3	3月23日	11:05	(18) システムインテグレーション実装技術	論文発表	MEMSプロセスを応用した微細樹脂-Si複合構造体の作製	○水崎英明 [†] 、佐藤彰 ^{††}	[†] 長野県工業技術総合センター、 ^{††} タカノ㈱
23C1-1	3月23日	9:00	(08) 材料技術1	依頼講演	ポスト5G/6Gで求められるエレクトロニクス実装材料技術	○八甫谷明彦	㈱ダイセル
23C1-2	3月23日	9:30	(08) 材料技術1	論文発表	エレクトロニクス分野におけるPEEKとその発泡体の開発	○明石達樹 [†] 、六田充輝 ^{††} 、西村浩之 ^{†††} 、田中佳典 ^{†††}	[†] ダイセル・エポニック(株)、 ^{††} (株)ダイセル、 ^{†††} (株)イノアックコーポレーション
23C1-3	3月23日	9:45	(08) 材料技術1	論文発表	バンプレス接合によるWafer-On-Wafer積層用高耐熱性樹脂の開発	○新木直子 ^{†††} 、福田匡志 ^{††} 、大場隆之 ^{††}	[†] (株)ダイセル、 ^{††} 東京工業大学
23C2-1	3月23日	10:20	(08) 材料技術2	論文発表	反応誘起相分離で形成された液晶を含むエポキシ変性シアネートエステル樹脂の物性	○柳浦聡、原田美由紀	関西大学
23C2-2	3月23日	10:35	(08) 材料技術2	論文発表	脂環式エポキシ樹脂の開発及び用途展開	○竹中洋登、鈴木弘世、中谷晃司	(株)ダイセル
23C2-3	3月23日	10:50	(08) 材料技術2	論文発表	LCPにおけるプリスターに関する最新の知見	○長永昭宏	ポリプラスチックス㈱
23C2-4	3月23日	11:05	(08) 材料技術2	論文発表	アオコおよび活性汚泥を用いた微生物燃料電池(MFC)の試み	○カビールムハムドゥル、蛭谷創、山城屋陽大、小原直子	秋田大学
23C2-5	3月23日	11:30	(08) 材料技術2	論文発表	Zn/Agめっきによる焼結Agの接合強度向上メカニズムの検討	○上山椋平、山崎浩次	三菱電機(株)
23C2-6	3月23日	11:45	(08) 材料技術2	論文発表	ボイドレス接合用銀ペースト及び新規銅ペースト	○江川智哉、小畑貴慎、坂谷亮 [†] 、菅沼克昭 ^{††}	[†] (株)ダイセル、 ^{††} 大阪大学
23P1-1	3月23日	12:00	ポスターセッション(コアタイム)	ポスター発表	フレキシブル透明TFT基板等を目指した新規ポリイミドフィルムの開発	○涌井洋行、横山正幸、中村誠、米虫治美、水口伝一朗、北村幸太	東洋紡㈱
23P1-2	3月23日	12:00	ポスターセッション(コアタイム)	ポスター発表	超小型IoT衛星搭載用CMG姿勢制御システムの開発	○野口凌平、古郡葉子、塚原彰彦、田中慶太	東京電機大学
23P1-3	3月23日	12:00	ポスターセッション(コアタイム)	ポスター発表	超小型IoT衛星搭載用姿勢制御システムの開発	○佐藤圭、塚原彰彦、田中慶太	東京電機大学
23P1-4	3月23日	12:00	ポスターセッション(コアタイム)	ポスター発表	超小型IoT衛星のコマンド及び衛星軌道情報の送受信システムの開発	○松本優樹、塚原彰彦、田中慶太	東京電機大学
23P1-5	3月23日	12:00	ポスターセッション(コアタイム)	ポスター発表	超小型衛星に用いるCommand and Data Handlingシステムの開発	○堀口拓海、田中慶太、塚原彰彦	東京電機大学
23A3-1	3月23日	14:10	特別講演	依頼講演	さらに加速するAIの産業応用	○白石 洋一	群馬大学
23A3-2	3月23日	15:10	特別講演	依頼講演	イノベーションの源泉となる DE&I	○梶原ゆみ子	富士通株式会社
23A3-3	3月23日	16:20	特別講演	依頼講演	先端半導体製造技術の動向と次世代コンピューティング基盤戦略	○安田 哲二	産業技術総合研究所